



POLITECNICO
DI TORINO



Incontro con Regione Piemonte
5 marzo 2018

POR FESR 2014-2020 - Azione I.1b.1.2 – Poli di Innovazione – Agenda Strategica di Ricerca 2016

Progetto Smart XLPCHE

STV Italia srl
Dott. Alessandro Vaiarelli
CEO STV Group



Executive summary del progetto: Smart XLPCHE

Sviluppo di un nuovo processo produttivo (**SMART**) basato sulla saldatura per Diffusion Bonding (DB) con tecnologia HIP (Hot Isostatic Pressing) di piastre metalliche foto incise di grande formato prodotte dal Gruppo STV. Tale processo è indirizzato a produrre monoliti metallici, micro canalizzati, di grandi dimensioni (**XL**) e ad alta trasmissibilità termica da utilizzare per la realizzazione di scambiatori di calore ad alte prestazioni di temperatura e pressione detti **Printed Circuit Heating Exchanger**).

Cos'è un
Printed Circuit Heating Exchanger



Scambiatori termici super compatti per applicazioni estreme:

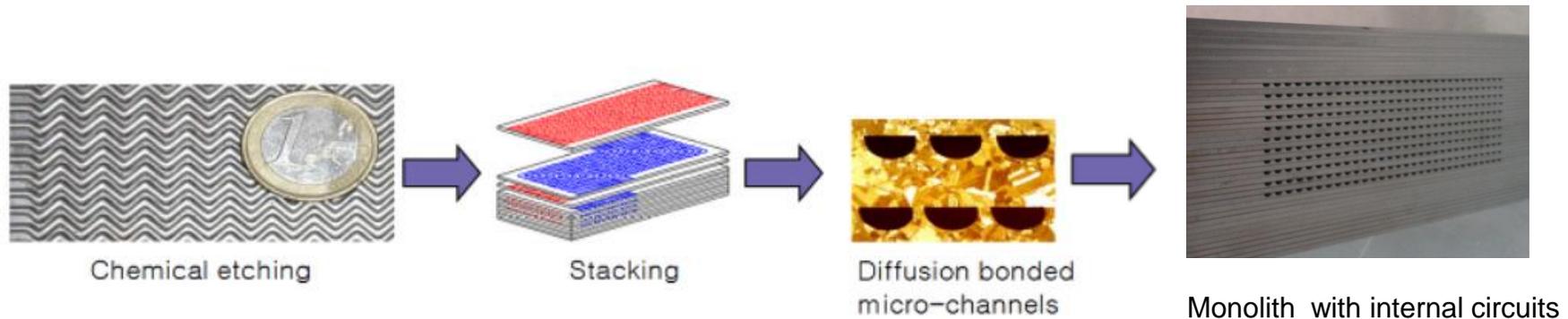
- Piattaforme off shore
- NGLV - Natural Gas liquefied Vessel
- Power generation
- Chemical processing

Costo totale: € 600.303

Contributo totale: € 360.181

Descrizione del progetto

Il core dei **Printed Circuit Heating Exchanger** è costituito da un monolite ottenuto da strati di piastre metalliche foto incise, contenenti i circuiti, trasformate in monolite attraverso la saldatura allo stato solido delle superfici (Diffusion Bonding).



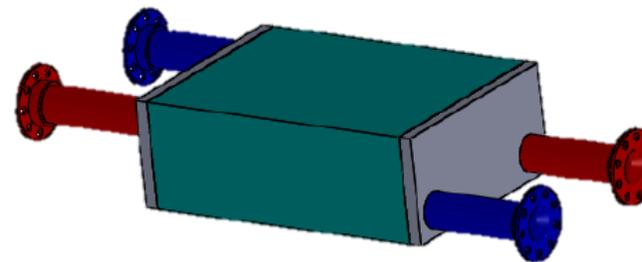
La tecnologia è stata sviluppata e brevettata (brevetto ormai scaduto) da un'azienda inglese che opera in regime di monopolio di fatto.

La **tecnologia attualmente utilizzata** per il DB è la Hot Uniaxial Pressing (**HUP**) in alto vuoto, che permette di ottenere blocchi parallelepipedi di **dimensioni massime 500x600x1200 mm**. Il vincolo dimensionale dei blocchi comporta limitazioni di progetto e perdite di efficienza rendendo spesso necessario l'utilizzo di più moduli in serie.

Descrizione del progetto

La **tecnologia proposta**, basata sulla separazione dell'alto vuoto (realizzato in capsule off line) dal trattamento termico in alta pressione isostatica (**HIP**), permetterà la realizzazione di nuclei metallici monolitici canalizzati decisamente più grandi di quelli attuali, fino a **1000x1000x 2500 mm** che potranno avere diverse forme geometriche.

Questa innovazione permetterà di integrare altre componenti al nucleo scambiatore come condotti e flange oggi non integrati, il risultato sarà un dispositivo più compatto, sicuro, performante ed economico.



Dispositivo tradizionale a 5 blocchi+ raccordi = 25 m³

Dispositivo monolitico = 2,5 m³

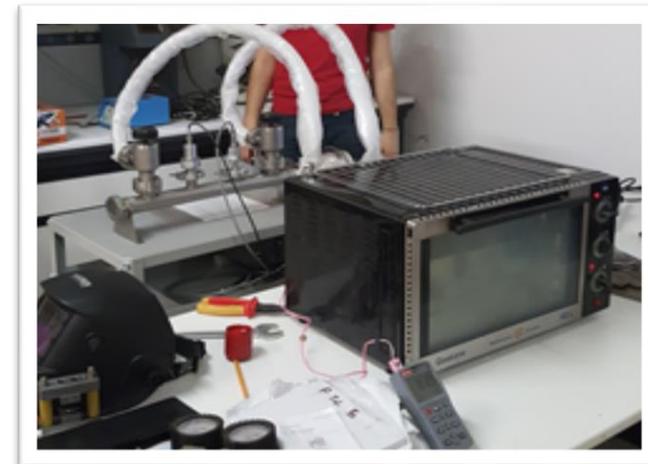
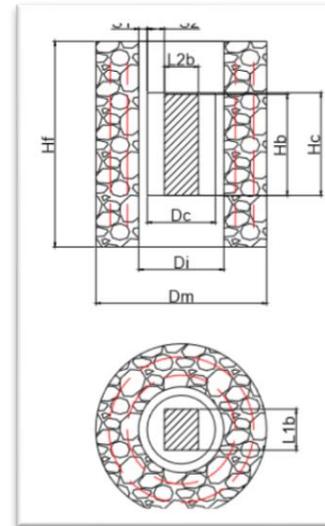
WP1 - Allestimento laboratorio per test e assemblaggi propedeutici ai processi di DB

Obiettivi

Progettare e realizzare il laboratorio per la preparazione dei campioni di test e l'assemblaggio dei blocchi da trattare in Diffusion Bonding realizzando 2 dispositivi ad hoc per il progetto di ricerca.

Task 1 - Costruzione muffola integrata con carico monoassiale e controlli di temperatura

Task 2 - Costruzione dispositivo per la messa sotto vuoto molecolare



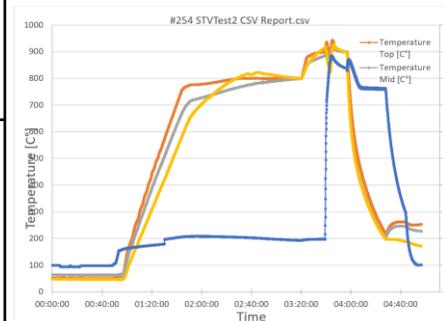
WP2 - Consolidamento Know how DB

Obiettivi

Approfondire la sensibilità delle principali variabili di processo, sviluppare la tecnica dell'incapsuling e studiare gli effetti fisico strutturali nei processi HIP.

Task 1 - Analisi di sensitività delle variabili DB su campioni da laboratorio

Task 2 - Realizzazione di blocchi da laboratorio in HIP per test metallografici e verifica calcolo strutturale



WP3 - Realizzazione prototipi di dispositivi XLPCHE

Obiettivi

Progettare, realizzare e testare dispositivi XLPCHE via via di dimensioni e complessità crescenti.

Task 1 - Realizzazione di piccoli blocchi per verifica calcolo CFD

Task 2 - Realizzazione blocchi media dimensione per primo up scaling e verifica modello di ottimizzazione

Task 3 - realizzazione di blocchi di grande dimensione per secondo up scaling



WP4 - Modellizzazione fisico strutturale in condizioni HIP

Obiettivi

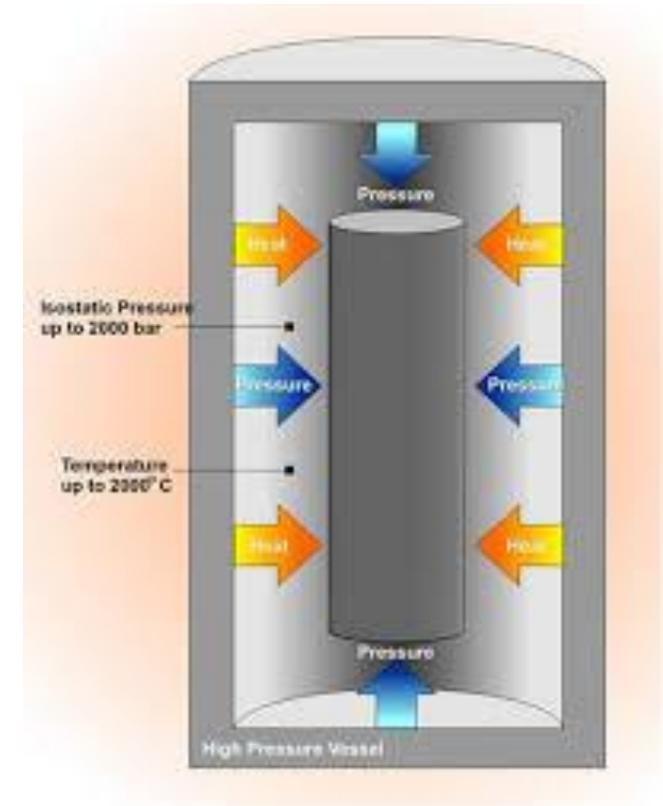
Sviluppo di un modello di calcolo strutturale e della relativa metodologia applicativa per la valutazione dell'integrità strutturale e delle variazioni di sezione dei canali realizzati nelle piastre fotoincise durante il processo HIP.

Task 1 - Sviluppo modello e metodologia per la valutazione dell'integrità strutturale durante il processo HIP

Task 1.1 - Studio modalità di simulazione strutturale mediante FEM del processo di diffusion bonding

Task 1.2 - Sviluppo microcella strutturale e definizione metodologia di calcolo termomeccanico accoppiato

Task 1.3 - Sviluppo macrocella e definizione procedura di upscaling strutturale termomeccanico della struttura costituente la microcella.



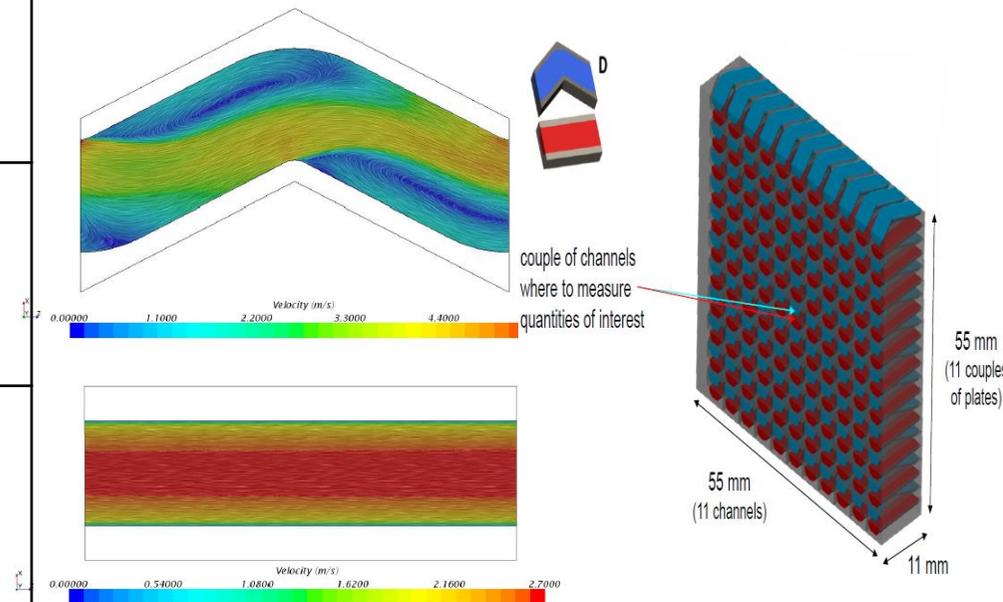
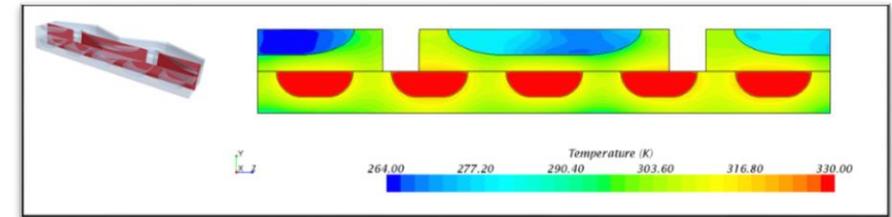
WP5 - Modellizzazione termodinamica di PCHE

Obiettivi

Sviluppo di un modello di calcolo CFD e della relativa metodologia applicativa per la valutazione delle prestazioni globali dello scambiatore e per l'ottimizzazione delle stesse accoppiando la valutazione termostrutturale con l'analisi fluidodinamica.

Task 1 - Sviluppo metodologia per analisi CFD full scale scambiatore

Task 2 - Sviluppo metodologia per ottimizzazione prestazioni scambiatore



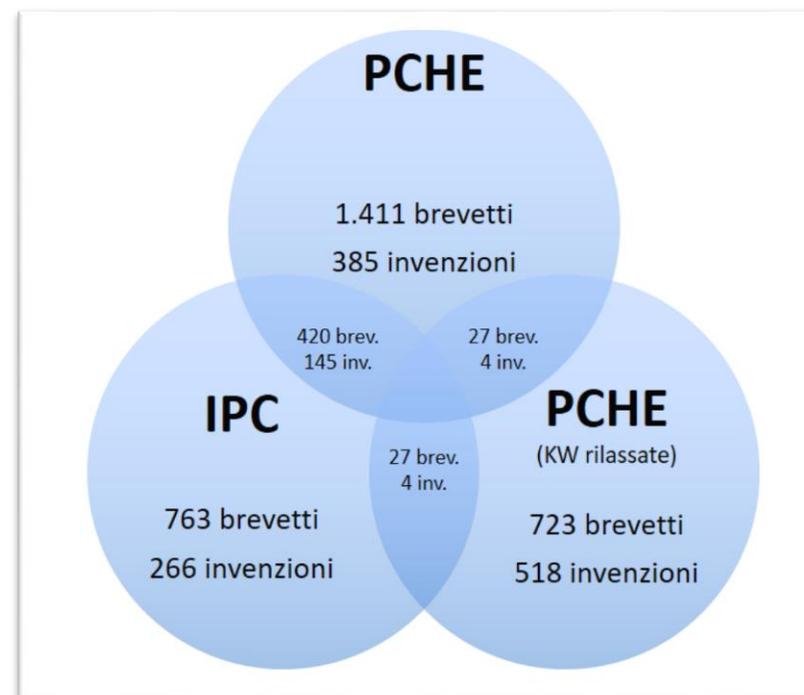
WP6 - Valutazione aspetti Brevettuali

Obiettivi:

Verificare la brevettabilità di alcune soluzioni proposte

Task 1- Valutazione aspetti brevettuali

Valutazione complessiva dei brevetti in essere nel settore e analisi di brevettabilità di alcune soluzioni innovative derivanti dal progetto di ricerca



Partenariato

Capofila — STV Italia srl

Chi siamo

STV Italia è la capogruppo di 5 aziende con sedi produttive in Italia, Francia, Ungheria, Romania e Brasile. Da oltre 50 anni il gruppo opera nel mercato della fotoincisione industriale per la produzione di matrici di stampa serigrafica e di componenti metallici foto incisi chimicamente.

STV Italia in quanto capogruppo oltre a fornire i servizi generali e finanziari, si occupa della pianificazione strategica e della ricerca ed innovazione per l'intero gruppo.

Cosa facciamo nel progetto

STV Italia, oltre ad essere capofila, promotore e coordinatore del progetto si occuperà della sperimentazione e realizzazione dei Nuclei Metallici canalizzati e dei prototipi di SMART XLPCHE al fine di definire parametri e criticità di processo per l'uso di questa tecnologia in un ambito industriale.

Partenariato

Partner — Amet srl

Chi siamo

La missione di AMET è fornire soluzioni nell'ambito delle metodologie, tecnologie e servizi di ingegneria per la progettazione e lo sviluppo di prodotti industriali, sfruttando un approccio basato su modello multi-dominio integrato, per garantire prestazioni ottimali del sistema. Le competenze AMET si concentrano su: Simulazione numerica (CAE) e Controlli Automatici. In particolare sulla simulazione numerica AMET possiede competenze elevate in diverse discipline, dalla statica alla dinamica lineare, dalla sicurezza passiva alla biomeccanica, sino al CFD ed all'analisi termica e termofluidodinamica

Cosa facciamo nel progetto

Il ruolo di AMET è quello di sviluppare una procedura integrata che permetta di definire le caratteristiche geometriche micro/macro del nucleo monolitico necessarie per permettere allo scambiatore di soddisfare i requisiti prestazionali globali richiesti.

Trasferimento Tecnologico

OdR - Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino oltre a svolgere il ruolo del coordinatore scientifico, avvalendosi dei propri laboratori, supporterà le aziende nella definizione delle metodologie e nella realizzazione delle :

- Analisi metallografiche,
- Prove termofluidodinamiche per validare i modelli di calcolo e simulazione
- Analisi brevettuale

Risultati attesi

- Sviluppo ad un livello TLR 7 della tecnologia per la realizzazione di grandi monoliti metallici canalizzati con tecnologia DB/HIP.
- Creare le condizioni per la realizzazione di dispositivi dimostratori di grande formato su specifiche di potenziali End User.
- Rafforzare e qualificare l'offerta del gruppo STV da fornitore di piastre foto incise a fornitore di dispositivi innovativi

Grazie

Dott. Alessandro Vaiarelli

STV Italia srl

Tel. +39 011 19665011

alessandro.vaiarelli@stv-group.com